

SG 5501 导热硅脂

产品特点

- 单组分导热硅脂
- 优异的电气绝缘性
- 优异的导热性能
- 低油离
- 适宜的流变性
- 宽泛的使用温度范围
- 通过RoHS环保认证

产品用途

WANICONE® SG 5501 是一款应用于电子器件组装的导热硅脂,可以使产生的热量有效地传到环境中,从而避免电子元件过热而造成产品性能和寿命的问题,以满足电子元器件日益微型化对材料导热的要求。

可用于 CPU、电源、服务器以及汽车电子的散热。

性能参数

项目	指标	单位
颜色	白色	--
粘度 (25℃)	66280	mPa s
密度	2.12	g/cm ³
导热率	0.8	W/mK
最大颗粒	25	um
挥发成分	<1	%
体积电阻率	1.3×10 ¹⁶	ohm cm

包装规格

2.6L/硬支或 1kg/罐, 或按照客户指定包装形式。

贮存条件和保质期

自生产之日起, 未开封的 WANICONE® SG 5501 在 28℃ 以下的保质期为 24 个月。

使用方法

- 表面处理
基材表面需干燥、清洁，去除锈迹、灰尘和油污等。
可使用的清洗溶剂包括酒精、丙酮等。
- 施胶
将硅脂涂在电子器件或散热器的平面上。
将电子器件与散热器的平面压紧，使导热硅脂在两个平面之间形成非常薄的界面。
将散热器加固。

使用注意事项

- 导热硅脂接触的电子器件和散热器的平面要尽量平整。
- 如果硅脂在容器内有表面浮油，使用前搅拌混合均匀。
- 尽量避免过多气泡夹杂于硅脂中。
- 加固散热器的力度要适当平衡，以确保导热硅脂界面厚度均匀。

环境健康

有关安全环保方面的信息，请参阅我公司产品的安全数据说明书或与我公司客户服务中心联系。

版本信息

TDS 编号：PCS_3027

首次发布日期：2017年08月01日 版本号：V 1.0

第一次修订：2017年12月20日 版本号：V 2.0

第二次修订：2018年08月10日 版本号：V 3.0 修订原因：商标上标“TM”变更为“®”

本资料所给出的指标、数据乃基于我们现有的技术知识水平和实践经验，仅供参考。具体保证指标以质量保证书或供货合同规定为准。用户对于所购买我公司的产品有责任进行试验，以验证是否适合各自所拟定的工艺和用途，并达到预定的目的。对我公司产品的进一步应用和加工均非我公司所能控制，因此，我们对所提供的产品的责任范围只限于我方交付且为贵方所使用的部分。而不承担在采用我公司产品为原料进行生产过程中而造成的间接损失。我公司市场部技术支持与客户服务中心愿为您提供有关产品的咨询与应用技术服务，欢迎来函来电联系。

联系地址：山东省烟台市经济技术开发区天山路 17 号 邮编：264006

客户服务中心咨询电话：+86 (535)-8203244 传真：+86 (535)-3388222-3244

<http://www.whchem.com>

E-mail: PCS@whchem.com